



2020年9月10日

ニュースリリース

シリコン・ラボ、Bluetooth Low Energy ポートフォリオの新製品「BGM220S/220P」を発表 クラス最高クラスの電力効率、サイズ、セキュリティソリューションを備えたシリコン・ラボの Bluetooth Low Energy 対応モジュールが、優れた RF パフォーマンスを実現

よりスマートでコネクテッドな世界のためのシリコン、ソフトウェア、ソリューションのリーディングプロバイダであるシリコン・ラボ (NASDAQ: SLAB) は、IoT デベロッパー向けに、業界トップクラスの RF パフォーマンスを示す Bluetooth® Low Energy ソリューションのポートフォリオを拡大する新製品「BGM220S/220P」を発表しました。シリコン・ラボは業界に先駆けて、SoC (System-on-Chip)、SiP (System-in-Package) モジュール、PCB モジュール、ネットワーク・コプロセッサ (NCP) など、Bluetooth 5.2 に対応した高いパフォーマンスで柔軟性に富んだ豊富なパッケージを提供します。シリコン・ラボの IoT ソリューションは、クラス最高のパフォーマンスと最先端のセキュリティを特徴としており、電力効率、コスト、サイズ、ターンキーによる簡便さなどの面で最適化が施されています。BGM220S/220P の納期・価格については、シリコン・ラボ国内販売代理店にお問い合わせください。

BGM220S のパッケージサイズは 6 x 6 mm で、Bluetooth 対応 SiP モジュールとしては世界でも最小クラスの製品です。超小型で低コスト、バッテリー寿命が長い SiP モジュールとして、超小型製品向けのターンキー Bluetooth 接続ソリューションをご提供します。同時に発表された BGM220P は、わずかにサイズが大きくなりますが、PCB 製品として優れたワイヤレス性能により、広い通信距離を確保できるリンクバジェットを実現します。BGM220S と BGM220P は、Bluetooth Direction Finding に対応した Bluetooth モジュールの先駆けとなる製品であり、1 個のコイン電池で 10 年に及ぶバッテリー寿命が確保されます。

シリコン・ラボで IoT 担当シニア・バイス・プレジデントを務める Matt Johnson は、次のように述べています。「シリコン・ラボの Bluetooth Low Energy 製品ポートフォリオは、クラス最高のパフォーマンス、パワー、セキュリティ機能を備えた、業界でも類を見ない充実したワイヤレス・ソリューションです。シリコン・ラボは長年にわたり、メッシュ、マルチプロトコル、独自規格、Thread、Zigbee、Z-Wave など、広範な IoT ワイヤレス技術で実績を重ねてきました。現在では Bluetooth Low Energy 関連で主導的なポジションを獲得すべく、ワイヤレス分野で培った専門性を集中的に投入していますが、すでにセキュアな Bluetooth 5.2 SoC 製品が好調な成績を上げています。2020 年 1 月に発売した BG22 シリーズは、製品の採用や商談パイプラインの拡大がかつてないペースで進んでおり、コンシューマー、医療、スマートホーム分野で製品が続々と導入されています」

Bluetooth SIG が発表した [2020 Bluetooth Market Update](#) によれば、Bluetooth Low Energy の年平均成長率は 26% であり、Bluetooth 分野の中でも顕著な拡大を見せています。

業界をリードするハイパフォーマンスと最先端のセキュリティ

シリコン・ラボは、業界でも最高度のパフォーマンスとセキュリティを誇る Bluetooth Low Energy SoC 製品と各種モジュールを提供しています。SoC は、カスタマイズ性に優れたソフトウェアと RF 設計オプションが特長で、IoT デバイスの開発に高度な柔軟性を求める IoT 製品メーカーに最適です。これに対して SiP モジュールは、Bluetooth Low Energy 認証済みであり、RF 設計やエンジニアリングをほとんどまたはまったく必要としない、最小のフォーム・ファクターです。また PCB モジュールは、低コストで、かつ SiP モジュールが有する多くの利点が得られるのが特長です。

シリコン・ラボのシリコン／モジュールソリューションは、ゲートウェイ、ハブ、スマート照明など、要求が厳しい用途でのマルチプロトコル接続もサポートしています。シリコン・ラボは、ワイヤレス・メッシュ・ネットワーキングをリードしてきた実績を基礎に、ハイパフォーマンスの Bluetooth Low Energy 製品ラインに、[Secure Vault](#) と呼ばれる最先端の[セキュリティ機能](#)を搭載した製品を投入します。Secure Vault は、IoT デバイス向けの最も進化したハードウェア／ソフトウェア・セキュリティ保護製品群です。デバイス・メーカーにおけるブランド、製品設計、コンシューマー・データの保護が容易です。

シリコン・ラボは 2020 年 9 月 3 日(日本時間)に、Secure Vault を搭載した新しい [EFR32MG21B](#) マルチプロトコルワイヤレス SoC が [Arm PSA Level 2 認定](#) を取得したと発表しました。そのベースになっているのが、IoT のセキュリティ標準化を促進し、セキュリティが製品化までの時間短縮を阻害している要因を排除し、包括的な保証フレームワークで、Arm PSA Level 2 認定を取得する最初の無線製品になったのが EFR32MG21B です。

今年 8 月には、[EFR32xG22 Wireless Gecko シリーズ 2 開発キット](#) が、ioXt Alliance を通じて ioXt SmartCert セキュリティ認証を取得しました。ioXt Alliance Certification Program は、IoT におけるセキュリティの進化を目指す提携であり、[8 つの ioXt 保証原則](#) に照らしてデバイス进行评估します。そして適切なセキュリティ基準以上のデバイスだけに ioXt SmartCert が認定されます。

シリコン・ラボの Bluetooth Low Energy 製品には、Secure Element を搭載した [EFR32BG21A](#) SoC モジュールと [BGM210PA](#) モジュールが含まれています。Secure Vault を備えた新しい [EFR32BG21B](#) SoC は発売が開始されており、同じく Secure Vault を備えた BGM210PB モジュールは、年内発売の予定です。

優れた電力効率とコスト削減効果

シリコン・ラボは、低コスト、低消費電力、優れたメモリ効率、優れた RF パフォーマンスを特徴とする、最適化された Bluetooth Low Energy ソリューション群を提供しています。これには、Root of Trust および Secure Loader によって強化された Secure Boot を含むセキュリティ機能が搭載されています。Silicon Labs の最適化された Bluetooth Low Energy ソリューションは、ワイヤレス・センサー、アクチュエーター、ポータブルな医療タグやアセットタグを含む、バッテリー駆動のエンドノードなどの用途に最適であり、BGM220 モジュールはその代表的なものです。超小型かつ低コスト設計で、1 個のコイン電池で 5~10 年の寿命が得られます。CE、FCC、及び TELEC の認証だけでなく、Bluetooth 認証をも含む、ターンキーの事前認証済モジュールで製品化はさらに加速します。

シリコン・ラボの最適化された Bluetooth Low Energy 製品には、受賞歴のある [EFR32BG22](#) SoC や新 BGM220P/S モジュールが含まれています。

ターンキーBluetooth Low Energy 向けネットワーク・コプロセッサにより、製品化までの時間が短縮
製品化までの時間を重視する IoT 製品メーカーには、設計と開発のサイクルを事実上必要としない、Silicon Labs NCP が最適です。Silicon Labs NCP では、既存のマイクロコントローラー・ユニット(MCU)に、Root of Trustなどのセキュリティ機能を備えた認証済みターンキーBluetooth ソリューションを簡単に追加できます。

シリコン・ラボは、新しい Bluetooth Xpress BGX220 事前認証済 PCB モジュールおよび SiP モジュールにより、NCP ポートフォリオを拡張しています。年内発売予定の UART-Bluetooth Low Energy ブリッジ・モジュールである BGX220 は、セキュアな Bluetooth Low Energy 接続製品を製品化するための最速のツールです。BGM220 と同様に、Bluetooth Xpress BGX220 では認証済ハードウェア・プラットフォームが用意されているため設計が簡素化されます。外付けのマイクロコントローラーと合わせて使用できるシンプルな API までが実装されているため、コード開発の効率が向上します。

シリコン・ラボのクラス最高の Bluetooth Low Energy SoC 製品群、モジュール、ネットワーク・コプロセッサ、ソフトウェアおよび開発者向けリソースの詳細は、<http://silabs.com/wireless/bluetooth> をご覧ください。Secure Vault はじめ Silicon Labs の IoT セキュリティ機能については、<https://www.silabs.com/security> をご覧ください。

シリコン・ラボについて

シリコン・ラボ (Silicon Labs, NASDAQ: SLAB) は、よりスマートでコネクテッドな世界を実現するためのシリコン、ソフトウェア、ソリューションを提供するリーディングプロバイダです。当社の受賞歴のある技術は、モノのインターネット、インターネットインフラ、産業用オートメーション、消費者市場、自動車市場の未来を形作っています。当社のワールドクラスのエンジニアリングチームは、性能、省エネ、接続性、シンプルさに焦点を当てた製品を生み出しています。詳細は(silabs.com)をご参照ください。

###

報道関係者お問合せ先

Silicon Labs PR Contact: pr@silabs.com

ミアキス・アソシエイツ 河西: kasai@miacis.com

記事ご掲載時のお問合せ先

シリコン・ラボラトリーズ Y.K.

TEL: 03-5460-2411(代表) <http://jp.silabs.com>

株式会社マクニカ テクスターカンパニー

〒222-8561 横浜市港北区新横浜 1-6-3 マクニカ第 1 ビル

Tel: 045-470-9841 FAX: 045-470-9844

お問合せ: <https://www.macnica.co.jp/qsmail/tsc/>

<http://www.tecstar.macnica.co.jp/>

Cautionary Language

This press release may contain forward-looking statements based on Silicon Labs' current expectations. These forward-looking statements involve risks and uncertainties. A number of important factors could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements. For a discussion of factors that could impact Silicon Labs' financial results and cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements, please refer to Silicon Labs' filings with the SEC. Silicon Labs disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. Note to editors: Silicon Labs, Silicon Laboratories, the "S" symbol, the Silicon Laboratories logo and the Silicon Labs logo are trademarks of Silicon Laboratories Inc. All other product names noted herein may be trademarks of their respective holders.